

## 无损分析 (3D X-ray) 与扫描测量

X射线断层扫描测量主要应用于非接触内外部无损三维几何尺寸测量、材料结构分析、缺陷检测、装配检查、逆向工程应用等。适用于塑料、橡胶、硅胶、纤维、轻金属等多种材料，面向几何计量、科研、注塑、铝压铸、电池、汽车、医疗器械、包装、电子消费品等行业领域。

### 设备参数

1. 射线管电压：260KV；功率：260W；探测器像素：1035×1035；
2. 最大样品尺寸：φ300×360mm；升降台调节范围：160mm；放射源-探测器距离：1600mm。

### 内部缺陷定性定量分析

1. 测试并验证缺陷，填充不足、缺料、杂质、气泡等对产品可靠性造成严重影响的缺陷。
2. 检测复杂电子元件内部结构、电子组装产品焊接质量、其它零部件内部结构。
3. 检测玩具、塑料零部件、复合组装零部件等的界面结合或黏合情况。

### 几何尺寸测量

满足无损的多种几何尺寸测量，元素包括点、线、面、平面度、圆度、圆柱度、线轮廓度、渐开线塑料齿轮、齿形、齿廓、齿相等测量。

### 数模对比

样品测量数据域CAD模型的比对。

### 逆向工程应用

快速扫描与输出STL三维数据，同时可提供IGES、TXT多种曲线与云数据格式。

### 装配紧密度检测

1. 分析与测量与组件间装配形成的缝隙。
2. 提供二维与三维局部整体、透视或截面分析图。

### 问题溯源

1. 快速分析产品内外部故障原因：损伤、破裂、不良、断裂等。
2. 配合失效分析，可靠性分析中间样品无损检测分析。

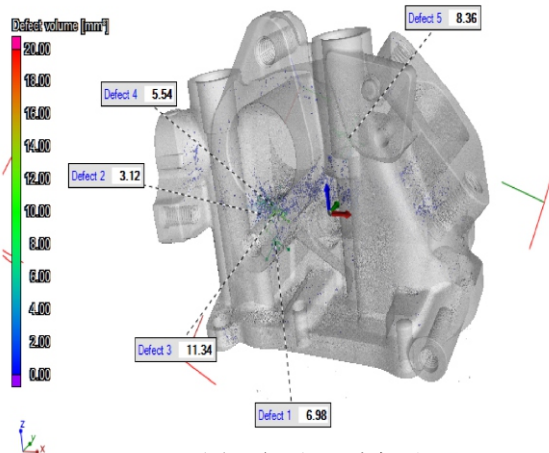


图1. 气孔尺寸标注

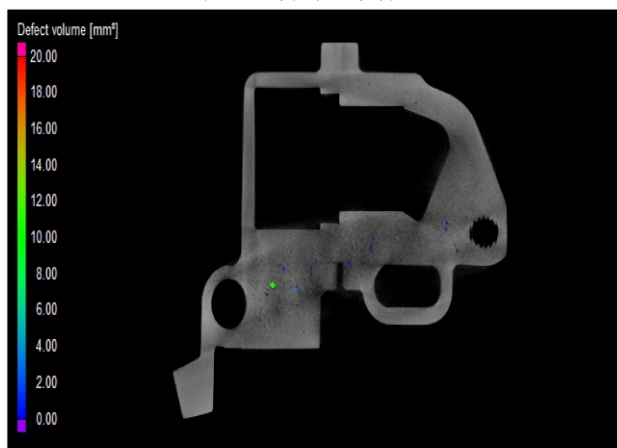


图2. 缺陷检查

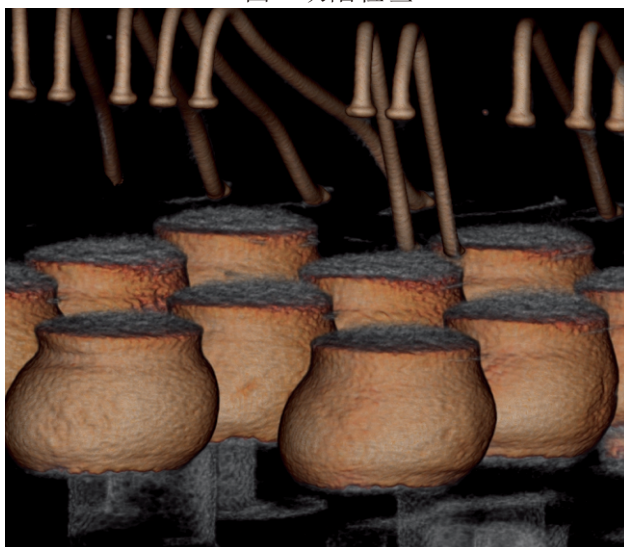


图3. BGA焊点观察

## 典型图片

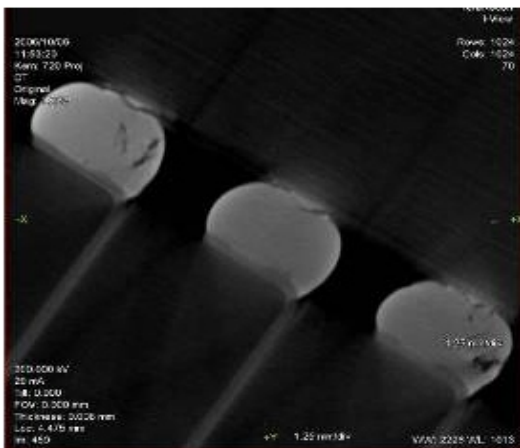


图4. BGA焊点观察

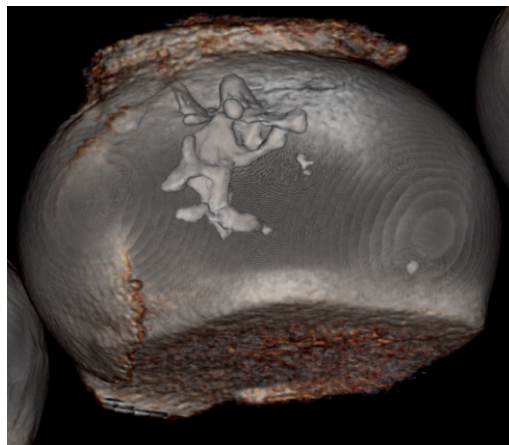


图5. BGA焊点观察



图6. 电池内部检查



图7. 电池内部检查

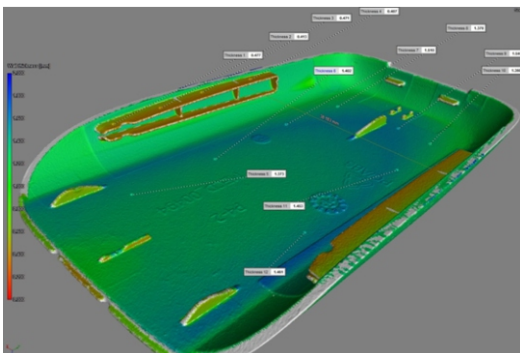


图8. 外壳尺寸测量

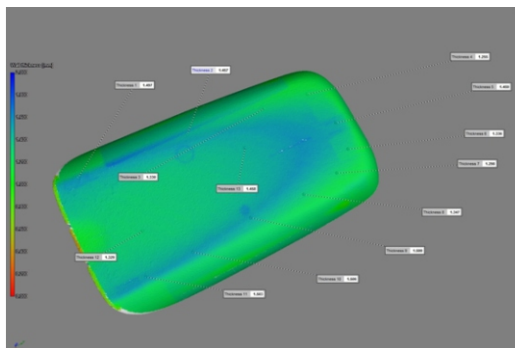


图9. 外壳尺寸测量

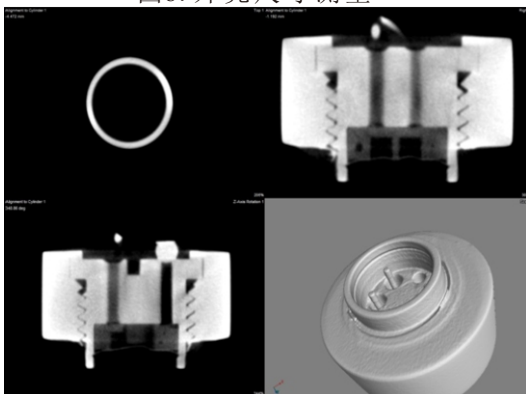


图10. 装配检查

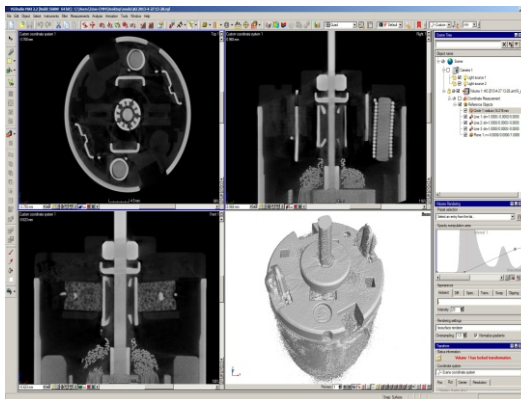


图11. 装配检查

## 敬请垂询

联系人：曾菲

电话：189 2932 2016 / 0755-27822721

邮箱：zengfei@mttlab.com

Tel: 400-850-4050

深圳市美信检测技术有限公司 | 深圳市宝安区石岩镇松白路石岩湖方正科技园A5栋1楼 | www.mttlalab.com